

惠州大亚湾西区科技创新园科技路1号创新大厦1号楼11层09号房
电话：(86 752) 5533798 传真：(86 752) 5533798-811

产品描述:

Tacusil™ 110047是针对电子组件接着所开发的单组分环氧树脂粘合剂。本产品硬化后具有良好的接着力。本产品为中低温硬化型树脂，适合用于各种材质间的接着，对塑料类的接着更优异。本树脂具有优良的耐久性，通过许多不同的环境测试，适合用于记忆卡和C-MOS的组装与热感组件的粘结。

产品特性:

- 本产品为无溶剂型单组分环氧树脂。
- 本树脂硬化物的表面不会出现油腻的现象，硬化物呈现低光泽。
- 在高湿度环境下，本产品仍然具有良好的电子绝缘特性。
- 本树脂硬化后对化学药品与溶剂均有良好的抵抗能力。
- 硬化物对于组件具有极佳的保护效果及耐震作用。
- 本树脂在相当大的温度范围内具有良好的尺寸安定性。
- 本产品符合2011/65/EU RoHS法规规范。
- 本产品符合氯<900ppm，溴<900ppm，氯+溴<1500ppm。

典型性能: 以下所有数据都在25°C条件测定。

特性:	数值:	单位:
颜色/状态	黑色粘稠液体	
黏度 @25°C, S14 5rpm	128,000 ~ 192,000	cps
触变指数	5	
填充物颗粒粒径	2~5um (Max 10)	um
填充物比例	32	%
氯含量 Chloride (Cl),	580	ppm
钾含量 Potassium (K)	<10	ppm
钠含量 Sodium (Na)	<30	ppm

公司對產品的適用性，商銷性等不作任何明示或暗示的保證。此外，以上資訊準備無誤，屬實可靠；但是，我們不對資料的準確性或使用資料獲得的結果作任何明示或暗示的保證。由於客戶使用產品的條件在我們控制之外，我們不對產品使用建議做任何保證。以上提供的典型性質值，不可當作產品的規格資料使用。使用者需要對產品進行測試以確定其具體用途的適用性。

惠州大亚湾西区科技创新园科技路1号创新大厦1号楼11层09号房
 电话：（86 752）5533798 传真：（86 752）5533798-811

比重	1.33	
硬度	90	Shore D
可使用时间25°C	2	day
建议固化时间@ 80°C	60	mins
@ 90°C	50	mins
@ 100°C	40	mins
@ 120°C	30	mins
@ 150°C	20	mins
玻璃转化温度(MDSC)	132	°C
玻璃转移温度 (TMA)	152	°C
热裂解温度 (TGA 10°C /min)	413	°C
热膨胀系数 (<Tg)	46	ppm
热膨胀系数 (>Tg)	162	ppm
吸水率 (25°C/ 24hr)	0.36	%
(80°C/ 24hr)	1.54	%
(97°C/ 1.5hr)	0.86	%
重量损失率@100°C	<0.5	%
@150°C	<0.5	%
@200°C	<0.5	%
@250°C	<0.5	%
@300°C	<0.5	%
@350°C	1.15	%
剪切强度 80 °C *60min,LCP vs. PCB-FR4	102	kg/cm ²
剪切强度 90 °C *50min,LCP vs. PCB-FR4	135	kg/cm ²
剪切强度 100 °C *40min,LCP vs. PCB-FR4	156	kg/cm ²
剪切强度 120 °C *30min,LCP vs. PCB-FR4	162	kg/cm ²
剪切强度 120 °C *60min,LCP vs. PCB-FR4	197	kg/cm ²
剪切强度 150 °C *20min,LCP vs. PCB-FR4	173	kg/cm ²

公司對產品的適用性，商銷性等不作任何明示或暗示的保證。此外，以上資訊準備無誤，屬實可靠；但是，我們不對資料的準確性或使用資料獲得的結果作任何明示或暗示的保證。由於客戶使用產品的條件在我們控制之外，我們不對產品使用建議做任何保證。以上提供的典型性質值，不可當作產品的規格資料使用。使用者需要對產品進行測試以確定其具體用途的適用性。

惠州大亚湾西区科技创新园科技路1号创新大厦1号楼11层09号房
 电话：(86 752) 5533798 传真：(86 752) 5533798-811

剪切强度 150 °C *60min,LCP vs. PCB-FR4	218	kg/cm ²
推力** PC vs. PCB-FR4,	2.6	Kg
PC vs. IR Glass,	3.8	Kg
PA vs. PCB-FR4,	0.4	Kg
PA vs. IR Glass,	2.4	Kg
LCP vs. PCB-FR4,	1.4	Kg
LCP vs. IR Glass	2.2	Kg
LCP lid vs. Epoxy	3.5	Kg
SBS vs. Epoxy	2.1	Kg
FR4 vs. Stainless Steel	2.9	Kg
LCP vs. Stainless Steel	9.6	Kg
Wafer Die vs. PCB	8.5	kg
材料拉深断裂强度, Epoxy sheet.	285	Kg/cm ²
伸长率	7.2	%
弯曲模数	11	GPa
杨氏系数 @ 25C,	8	GPa
@120C	0.4	GPa
体积收缩率	2.9	%
导热系数	0.5	W/mK
体积电阻	4.5*10 ¹⁵	ohm-cm
表面电阻	4.5*10 ¹⁴	ohm
介电常数 @100Hz	5.4	
@10KHz	5.6	
@1MHz	5.2	
介电损耗 @100Hz	0.02	
@10KHz	0.02	
@1MHz	0.03	
介电强度	16	KV/mm
耐温范围	-40~150	°C

试片烘烤条件：120°C / 30mins ** 试片硬化条件：80°C/ 60 min

公司對產品的適用性，商銷性等不作任何明示或暗示的保證。此外，以上資訊準備無誤，屬實可靠；但是，我們不對資料的準確性或使用資料獲得的結果作任何明示或暗示的保證。由於客戶使用產品的條件在我們控制之外，我們不對產品使用建議做任何保證。以上提供的典型性質值，不可當作產品的規格資料使用。使用者需要對產品進行測試以確定其具體用途的適用性。

惠州大亚湾西区科技创新园科技路1号创新大厦1号楼11层09号房
电话：（86 752）5533798 传真：（86 752）5533798-811

使用指南：

- 本产品需要冷冻库(-40°C ~ -5°C)储存，使用前请将产品分段放置于冷藏(2~10°C)下1小时再放到室温(14~34°C)下1~2小时回温。在尚未回温前，请勿打开容器的盖子，以免影响树脂的特性。
- 使用前需要先将接着表面清洁干净。
- 将接着剂均匀涂布在基材的两面。在接着剂硬化的过程中，最好能够施加适当的压力，以确保接着物的表面能够互相贴合。
- 实际物品的硬化时间会受到下列因素影响：①对象的几何形状，②对象的材质特性，③接着剂的厚度，④加热系统的效能。硬化的条件需要以实际的物品和条件来做最后的确认。

储存环境：

本产品需隔绝湿气与热源，以确保应有的储存安定性。在未开封前存放于冷冻库(-40°C~-5°C)，本产品保存期限六个月。请将本产品放置在室温(14~34°C)下回温1~2小时后可正常使用。如超过两天不使用时请放置于冷藏库，在室温下放置超过七天将导致本产品黏度发生变化。如超过原先黏度的两倍以上时，产品将建议不要再使用。

处置原则

某一些报导指出皮肤长期接触环氧树脂并不会诱发癌症病变。但是环氧树脂中的某些成分仍然可能会刺激皮肤，导致发炎红肿。当皮肤接触到本产品时，应以肥皂水将皮肤清洗干净，绝对不要使用有机溶剂来清洗。吞服本产品对人体仍有毒性，一旦误食，请马上送医诊治。避免眼睛接触到此产品，用户若不小心沾到眼睛时，要立即以大量清水冲洗眼睛至少15分钟以上再送医诊治。进一步的注意事项请详见物质安全数据表。

公司對產品的適用性，商銷性等不作任何明示或暗示的保證。此外，以上資訊準備無誤，屬實可靠；但是，我們不對資料的準確性或使用資料獲得的結果作任何明示或暗示的保證。由於客戶使用產品的條件在我們控制之外，我們不對產品使用建議做任何保證。以上提供的典型性質值，不可當作產品的規格資料使用。使用者需要對產品進行測試以確定其具體用途的適用性。